

# た か だ こ ら む

## 2025年 装置事業部展示会出展ハイライト

当社の半導体製造装置技術PRのため、2025年は国内外の主要展示会に積極的に出展し、新規顧客獲得や最新技術の情報収集を目指しました。

特筆すべきは、欧州最大級の半導体製造関連展示会であるSEMICON Europa 2025に初出展したことです。欧州市場への本格的なアプローチを開始する重要な一歩となり、現地企業とのビジネスチャンスを創出することができ、また新たな技術情報も獲得することができました。

本稿では、2025年に開催した展示会の実績の概要と、特に注目度の高かった展示会の詳細をご紹介します。

表1 2025年 出展実績

展示会名	開催場所	開催日程	総来場者数 2025年(名)	総来場者数 2024年(名)
SEMICON China 2025*	上海新国際博覧中心(中国)	3/26(水)~3/28(金)	180,715	159,896
JPCA Show2025(図1)	東京ビッグサイト	6/4(水)~6/6(金)	49,760	48,334
SEMICON India 2025*	Yashobhoomi(インド)	9/2(火)~9/4(木)	30,000以上	10,994
ICSCRM 2025*	BEXCO(韓国)	9/14(日)~9/19(金)	2,232	1,728
EMPC 2025*	WTC Grenoble(フランス)	9/16(火)~9/18(木)	約440	未開催
ネプコンジャパン秋2025(図2)	幕張メッセ	9/17(水)~9/19(金)	30,905	22,623
SEMICON West 2025*	Phoenix Convention Center(アメリカ)	10/7(火)~10/9(木)	21,084	8,468
第2回[九州]半導体産業展(図3)	マリンメッセ福岡	10/8(水)~10/9(木)	13,640	7,314
TPCA Show TAIPEI*	台北南港展覧館(台湾)	10/22(水)~10/24(金)	66,233	59,783
SEMICON Europa 2025(図4)*	Messe München(ドイツ)	11/18(火)~11/21(金)	47,000	80,000
SEMICON Japan 2025(図5)	東京ビッグサイト	12/17(水)~12/19(金)	121,267	103,165

※本実績の一部は、商社様の出展ご協力の下、装置のPRを行っております。



図1 JPCA Show2025の様子



図2 ネプコン ジャパン秋 2025の様子



図3 第2回〔九州〕半導体産業展の様子



図4 SEMICON Europa2025会期中のブースの様子

## 1. SEMICON Europa 2025

SEMICON Europaは、今回で50周年を迎えた欧州最大規模の半導体関連展示会で、ドイツ・ミュンヘンにて毎年開催されています。出展にあたり、丸紅ブラックス株式会社様のブースをお借りし、共同出展させていただきました。

当社は、欧州での次世代パワーデバイスの需要調査も踏まえて、量産用「CSX501」と断面観察用「CSX-100 Lab」の超音波ダイシング装置のPRを行い、欧州展開に向けた重要な第一歩となりました。また、本展示会を通じて、複数の欧州大手半導体メーカー様のフォローアップを行うことができ、欧州展開への将来的な布石となりました。

### 【展示内容】

#### (1) パネル展示

- ・超音波ダイシングによる様々な優位性（高速切断・高品質・高寿命）をパネルにて紹介

#### (2) その他展示

- ・次世代パワーデバイスのPRを目的として6インチSiCウエハのダイシングサンプル
- ・スマートフォンを含む電子部品などの断面切断サンプル

## 2. SEMICON Japan 2025

SEMICON Japanは、半導体製造に関する国内最大級の国際展示会であり、東京ビッグサイトで毎年開催されています。半導体製造の前工程から後工程、パッケージング、テスト、材料、装置に至るまで、幅広いサプライチェーンを網羅する総合イベントです。最新技術の紹介や業界動向の共有、ビジネスマッチングの場として国内外の半導体メーカー、装置メーカー、材料メーカーが一堂に集結しています。

当社は、実機展示やブース内での複数回のプレゼンテーションを通じて、枚葉式ウェット処理装置のラインナップを紹介し、パワーデバイスなど多種多様なデバイス分野の製造工程における総合的なソリューションを

提案することができました。また、超音波カッティング装置については断面観察作業の効率化や切断品質の向上をPRしました。来場者からは「次世代装置への期待」や「高精度加工技術への関心」が多数寄せられ、当社の技術力を国内外の市場に強く印象づける機会となりました。なお、今回初の試みとして、来場者向けにお飲み物をご用意し、カジュアルな歓談の場とするハッピーアワーを1日限定で実施し、新たなコミュニケーション手法として広くお客様の声を収集することができました。

#### 【展示内容】

##### (1) 実機（モデル機）展示とパネル展示

###### <洗浄装置>

- ・ 枚葉式ウェット処理装置（TWPsa）のモデル機展示
- ・ NEWパネル：CMP後洗浄やダイシング後のバリ除去など薬品レスの水洗浄装置の紹介
- ・ TWPシリーズの紹介や4つの多彩な洗浄ノズルなどをアニメーション動画にて紹介

###### <切断装置>

- ・ 超音波カッティング装置（CSX501, CSX-100Lab）の実機・モデル機展示
- ・ 超音波アシスト切断の原理や効果などをアニメーション動画にて紹介
- ・ ダイシング装置としてSiC, AlNなどの切断事例やアルミナ基板の溝入れ加工を紹介
- ・ 超音波カッティング装置による断面観察試料製作作業の効率化のPRや切断事例の紹介

##### (2) その他展示

- ・ 装置生産能力のPRを目的として大口径化が進む8インチSiCやGaN基板などの切断サンプル
- ・ スマートフォンなどに使用される電子部品や車載用電子部品の断面切断サンプル
- ・ 超音波アシストの体験コーナーを設置

### 3. まとめ

各展示会で多くの方にご来場いただき、当社の装置や技術に関心をもっていただくとともに、国内外で新たなお客様を獲得することができました。この結果を踏まえて、より一層、お客様へ当社の装置や技術にご満足いただけるよう、邁進していく必要があると再認識する良い機会となりました。

今後も顧客ニーズに応える新技術開発と市場拡大に向け、挑戦を続けてまいります。

砥綿 太一（装置事業部）

※SEMICONはsemiの登録商標です。



図5 SEMICON Japan 2025の様子